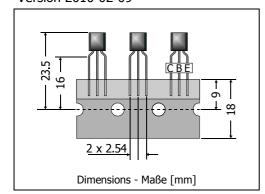


2N3904 NPN Si-Epitaxial-Planar Switching Transistors NPN Si-Epitaxial-Planar Schalttransistoren

Version 2010-02-09



Power dissipation Verlustleistung	625 mW		
Plastic case Kunststoffgehäuse	TO-92 (10D3)		
Weight approx. – Gewicht ca.	0.18 g		

Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack



Maximum ratings $(T_A = 25^{\circ}C)$

Grenzwerte ($T_A = 25$ °C)

			2N3904
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	40 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	60 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	6 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ¹)
Collector current – Kollektorstrom (dc)		\mathbf{I}_{C}	200 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_{j} T_{S}	-55+150°C -55+150°C

Characteristics $(T_j = 25^{\circ}C)$

Kennwerte ($T_j = 25$ °C)

		Min.	Тур.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ²)				
$\begin{split} &I_{\text{C}} = 0.1 \text{ mA,} V_{\text{CE}} = 1 \text{ V} \\ &I_{\text{C}} = 1 \text{ mA,} V_{\text{CE}} = 1 \text{ V} \\ &I_{\text{C}} = 10 \text{ mA,} V_{\text{CE}} = 1 \text{ V} \\ &I_{\text{C}} = 50 \text{ mA,} V_{\text{CE}} = 1 \text{ V} \\ &I_{\text{C}} = 100 \text{ mA,} V_{\text{CE}} = 1 \text{ V} \end{split}$	h _{EE} h _{EE} h _{EE} h _{EE} h _{EE}	4070 100 60 30	- - -	- 300 -
h-Parameters at/bei $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $-I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ kHz}$	I I I I			
Small signal current gain – Kleinsignal-Stromverstärkung	h _{fe}	100	_	400
Input impedance – Eingangs-Impedanz	h _{ie}	1 kΩ	-	10 kΩ
Output admittance – Ausgangs-Leitwert	h _{oe}	1 μS	1	40 μS
Reverse voltage transfer ratio – Spannungsrückwirkung	h _{re}	0.5*10-4	_	8*10-4

Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

² Tested with pulses $t_p = 300~\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ — Gemessen mit Impulsen $t_p = 300~\mu s$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$



Characteristics $(T_j = 25^{\circ}C)$

Kennwerte ($T_j = 25$ °C)

		Min.	Тур.	Max.
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannu	ung ²)			
$I_{C}=10$ mA, $I_{B}=1$ mA $I_{C}=50$ mA, $I_{B}=5$ mA	$\begin{matrix} V_{\text{CEsat}} \\ V_{\text{CEsat}} \end{matrix}$	- -		0.2 V 0.3 V
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ²)				
$I_{C}=10$ mA, $I_{B}=1$ mA $I_{C}=50$ mA, $I_{B}=5$ mA	$\begin{matrix} V_{\text{BEsat}} \\ V_{\text{BEsat}} \end{matrix}$	0.65 V -	_ _	0.65 V 0.95 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom				
$V_{CE} = 30 \text{ V}, V_{EB} = 3 \text{ V}$	I_{CBX}	_	_	50 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom				
- V _{CE} = 30 V, - V _{EB} = 3 V	I_{EBV}	_		50 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
I_C = 10 mA, V_{CE} = 20 V, f = 100 MHz	f⊤	300 MHz	_	_
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
$V_{CB} = 5 \text{ V}, \text{ I}_E = i_e = 0, \text{ f} = 1 \text{ MHz}$	C _{CBO}	_	_	4 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität				
$V_{EB} = 0.5 \text{ V}, I_{C} = i_{c} = 0, f = 1 \text{ MHz}$	C _{EBO}	_	_	8 pf
Noise figure – Rauschzahl				
V_{CE} = 5 V, I_{C} = 1 $\mu A,~R_{G}$ = 1 $k\Omega,~f$ = 1 kHz	F	_	_	5 dB
Switching times – Schaltzeiten (between 10% and 90% levels)				
delay time $V_{CC} = 3 \text{ V}, \text{ V}_{BE} = 0.5 \text{ V}$	t_{d}	_	_	35 ns
rise time $I_C = 10 \text{ mA}, I_{B1} = 1 \text{mA}$	t _r	_	_	35 ns
storage time $V_{cc} = 3 \text{ V, } I_c = 10 \text{ mA,}$	ts	_	-	200 ns
fall time $I_{\text{B1}} = I_{\text{B2}} = 1 \text{ mA}$	t _f	_	-	50 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R _{thA}	< 200 K/W ¹)		
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren			2N3906	

Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% - Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%
 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss